



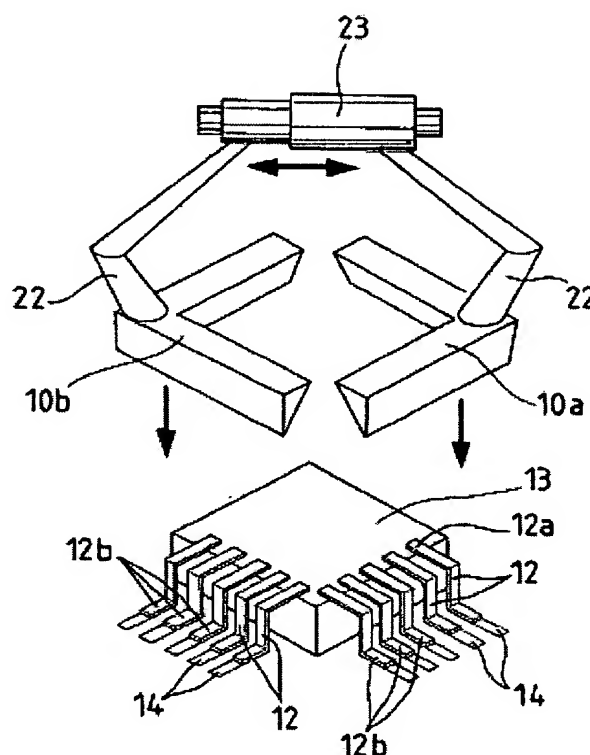


Device for laser soldering.**Patent number:** EP0510323**Publication date:** 1992-10-28**Inventor:** MOELLER WERNER DIPL-CHEM DR (DE);
KNOEDLER DIETER DIPL-ING (DE)**Applicant:** MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM (DE)**Classification:****- international:** B23K1/005; H01L21/60; H01L21/68; H05K13/04**- european:** B23K1/005R, H01L21/60G, H01L21/68, H05K13/04A2**Application number:** EP19920102723 19920219**Priority number(s):** DE19914105875 19910225**Also published as:** EP0510323 (B1)
 DE4105875 (C1)**Cited documents:** EP0326020
 JP2232999**Abstract of EP0510323**

The invention describes a device for the laser soldering of precision contacts of microelectronic components (where the solder is placed beforehand) by means of a laser assembly head which is carried and guided in a program-controlled and computer-controlled manner by a four-axis or six-axis robot or XY-table.

**FIG. 5**

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 510 323 A1**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 92102723.1

(51) Int. Cl.⁵: **B23K 1/005**, H05K 13/04,
H01L 21/60, H01L 21/68

(22) Anmeldetag: 19.02.92

(30) Priorität: 25.02.91 DE 4105875

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
28.10.92 Patentblatt 92/44

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT NL

(71) Anmelder: Messerschmitt-Bölkow-Blohm
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Robert-Koch-Strasse
W-8012 Ottobrunn(DE)

(72) Erfinder: Möller, Werner, Dipl.-Chem. Dr.
Ravensburger Strasse 77
W-7900 Ulm(DE)
Erfinder: Knödler, Dieter, Dipl.-Ing.
Fuchseckstrasse 39
W-7339 Eschenbach(DE)

(54) Einrichtung zum Laserlöten.

(57) Die Erfindung beschreibt eine Einrichtung zum Laserlöten von Feinkontakten vorbeloteter mikroelektronischer Bauelemente mittels eines Laser-Bestückungskopfes, der programm- und rechnergesteuert von einem Vier- oder Sechssachsenroboter oder XY-Tisch getragen und geführt wird.

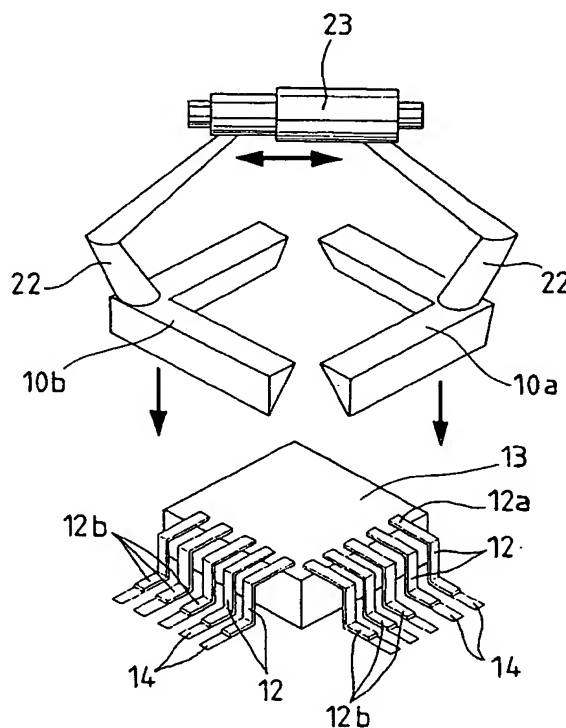


FIG. 5

EP 0 510 323 A1

Die Erfindung bezieht sich auf eine Einrichtung zum Laserlöten von Feinkontakten vorbeloteter mikroelektronischer Bauelemente gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Einrichtungen zur kurzzeitigen Fixierung von leicht verformbaren und mit einem Laser zu verlötenden Mikroteilen, die weder mittels Flußmittel noch mit Lotpaste miteinander verklebt werden, sondern lediglich vorbelotet sind, sind u.a. durch die Anmelderin bekannt geworden. Zum Stand der Technik werden die DE-OS 36 06 764 A1, die DE-PS 37 01 013 C2 sowie die DE 39 39 812.9 genannt, die einen Laserkopf mit einer Haltevorrichtung für Mikrokontakte beschreibt. Mit diesen Einrichtungen des Standes der Technik können vorverzinnte Mikroelektronik-Bauelemente mit sehr dünnen, zahlreichen, parallelen Kontakten (sog. Leads) und geringen Abständen (fine pitch) nach dem rationellen TAB-Lötverfahren (Tape Automated Bonding) einwandfrei miteinander verbunden werden.

Der Nachteil dieser Einrichtungen ist jedoch, daß der malteserkreuzartige Niederhalter bzw. die Haltevorrichtung eine für Mikro-Elektronikschaltungen zu große Fläche beansprucht und von den Bauelementgrößen sowie den Kontaktdimensionen abhängig bzw. spezifisch ist und bei einem Bauelementwechsel ausgetauscht werden muß. Wenn man nun in Betracht zieht, daß durch das Laserlöten von TAB-Kontakten der Vorteil gegeben ist, die Laserlöt-Koordinaten mit den Positionierungsdaten über ein Programm schnell ausgewechselt werden können und daher das Verfahren gegenüber den bisherigen des Stempelötens mit sehr spezifischen, eng in den Dimensionen tolerierten Thermoden-Werkzeugen sehr flexibel ohne lange Umrüstzeiten eingesetzt werden könnte, schränkt dieser Nachteil die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens sehr erheblich ein.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Einrichtung der eingangs genannten Art zu schaffen, die in einfacher und zuverlässiger Weise den vorgenannten Nachteil beseitigt und einen exakt positionierbaren Niederhalter für Mikrokontakte schafft, der schnell und hochgenau gegebenen Kontakt- bzw. Bauelement-Dimensionen auf engstem Raum angepaßt werden kann.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 aufgezeigten Maßnahmen gelöst. In den Unteransprüchen sind Maßnahmen zur Weiterbildung und Ausgestaltung angegeben und in der nachfolgenden Beschreibung sind Ausführungsbeispiele und Verfahrensmaßnahmen erläutert, wobei diese Erläuterungen durch die Figuren der Zeichnung ergänzt werden. Es zeigen:

Fig. 1 ein perspektivisches Schemabild des ersten XY-Tisches mit Z-Achsenverstellungseinrichtung und Laser-

Bestückungs- und Löt Kopfes,
 ein Ausführungsbeispiel eines Laser-Bestückungs- und Löt Kopfes wie er durch die Anmelderin bekanntgeworden ist,
 einen Querschnitt durch ein Ausführungsbeispiel eines Niederhalters für die Kontaktbügel eines Mikrochips,
 einen weiteren Querschnitt eines anderen Ausführungsbeispieles eines Niederhalters für die Kontaktbügel von Mikrochips,
 ein perspektivisches Schemabild für ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Niederhalters, der gleichzeitig zur Bestückung und Positionierung der Mikrochips dient,
 eine Seitenansicht des Ausführungsbeispieles gem. Fig. 4a, jedoch ohne die Z-Achsen-Verstelleinrichtung,
 ein perspektivisches Schemabild eines Ausführungsbeispieles für einen geteilten Niederhalter mit Format-Verstelleinrichtung,
 ein perspektivisches Schemabild für den XY-Tisch des Niederhalters und die optoelektronische Lageerkennung der Chipbestückung mit Korrektur-Blockschaltbild,
 eine spezielle Ausführungsform eines Niederhalters, der gleichzeitig Träger der Anschlußelemente für die Kontaktelemente ist, in Ausgangsposition, bei Verwendung eines Mehrachsenroboters,
 die Ausführungsform gem. Fig. 7a nach Abkopplung der Anschlußelemente vom Maskenrahmen und Laser-Bestückungskopf in schematischer Darstellung, bei Verwendung eines Mehrachsenroboters,
 die Ausführungsform gem. Fig. 7a und 7b bei zusätzlicher Abwinkelungsmöglichkeit des Laser-Bestückungskopfes in zwei Richtungen.

Die Fig. 1 veranschaulicht in schematischer Darstellung eine Bestückungsanlage zum Laserlöten von Feinkontakten mikroelektronischer Bauelemente, die weder mittels Flußmittel noch mit Lotpaste miteinander verklebt werden, sondern vorbelotet sind unter Einsatz eines XY-Tisches 140, einer Z-Achsen-Verstelleinrichtung 30 und eines Laserkopfes 100, wie er in der Fig. 2 skizziert ist.

Die Fig. 3a und 3b veranschaulichen nun in schematischer Darstellung, wie vorverzinnte Mikroelektronik-Bauelemente 13 - nachstehend Chip genannt - mit zahlreichen, sehr dünnen und parallel liegenden Kontakten (Leads) 12 in sehr

geringen Abständen nach dem TAB-Lötverfahren (Tape Automated Bonding) miteinander verbunden werden. Die in Fig. 1 gezeigte Z-Achsenverstelleinrichtung 30 ist mit einem rahmenförmigen Niederhalter 10 bestückt, dem gem. Fig. 4a ein sogenannter "Kapton-Rahmen" 11 zugeordnet sein kann.

Dieser Niederhalter 10 drückt nun über den Kaptonrahmen 11 oder direkt auf die Kontaktenden 12a der zahlreichen Kontaktbügel 12 des zu verlötenden Chips 13. Diese Kontaktenden 12a des Chips 13 sind nun so vorgeformt, daß durch eine definierte Druckbelastung ein mechanischer Kontakt 12b aller Kontaktbügel 12 an den Leiterbahnanschlüssen 14 erfolgt und an diesen Kontaktstellen 12b die Laserbondung erfolgt.

In der Fig. 3b ist eine Variante skizziert, bei der der Niederhalter 10 auf die Rückseite (gegenüber Fig. 3a gesehen) des Chips 13 drückt und die Kontakte 12 also auf der "Unterseite" des Chips 13 liegen. Mit 16 sind die Anschlußelemente der Kontaktbügel bezeichnet, die verschiedentlich auch als "Anschlußbeinchen" bezeichnet werden.

Die Funktion der in den Fig. 1 bis 3b skizzierten Laserlöteinrichtung kann wie folgt beschrieben werden:

Der mit einem Visionssystem versehene Mehrachsenroboter oder XY-Tisch, deren automatische Steuerung sowie der Bestückungs- und Laserbondkopf werden aktiviert. Daraufhin erfolgt die Kalibrierung, die Grobpositionierung des Bestückungskopfes 100 über dem Bauelement (Chip) 13, die Nach- und Feinpositionierung mittels des Visionssystems (siehe Fig. 6) gemäß der vorgegebenen Bauelement-Dimensionierung.

Der Bestückungskopf 100 fährt auf den Chip 13, der mittels eines Saugrüssels 21 aufgenommen und zur Schaltungsposition - beispielsweise Leiterkarte oder Hybrid 15 - transportiert und mittels des Visionssystems positionsgenau abgesetzt wird. Die Höhenlage des Saugrüssels 21 ist verstellbar. Nach dieser Positionierung erfolgt die Entlüftung des Saugknopfes bzw. Stempels 20 und das Absetzen des rahmenförmigen Niederhalters 10.

Die Fig. 4a und 4b veranschaulichen eine Ausführungsform des rahmenförmigen Niederhalters 10, der mit einem höhenverstellbaren Saugrüssel 21 an einem Stempel 20 für die gleichzeitige Bestückung und Fixierung des bzw. der Chips 13 versehen ist, wobei der rahmenförmige Niederhalter 10 mittels längenveränderlicher Rahmenhalter 22 mit dem Stempel verbunden ist.

Eine weitere Ausführungsform des rahmenförmigen Niederhalters 10 sieht vor, daß dieser in zwei Hälften 10a, 10b (Fig. 5) geteilt ist und den verschiedenen Kontaktgeometrien mittels einer Verstelleinrichtung 23 diagonal verstellbar ist. Dies kann sowohl mechanisch über ein Doppelgewinde

etc. aber auch pneumatisch unter Ausnützung der vorhandenen Pneumatik erfolgen, denn nach der Positionierung des Chips und Entlüftung des Saugknopfes 20 wird der Bestückungskopf 100 pneumatisch abgekoppelt und in die Nullposition bzw. die Laserposition gebracht.

Zum rahmenförmigen Niederhalter 10 ist noch anzuführen, daß er über einen ihm zugeordneten XY-Tisch 140 (Fig. 6) und ein Bilderkennungssystem 120 sowie einem Korrektursteuersystem 130 zur exakten Position gebracht wird. Um Laserstrahlabschattungen zu vermeiden, ist der Niederhalter 10 sehr flach konzipiert. Vorteilhaft wirkt sich auch eine unterseitige rasterförmige Teflon-Isolationsschicht 17 aus.

Der rahmenförmige Niederhalter 10 wird also vor und nach dem Löten pneumatisch in Z-Richtung hochgefahren, unmittelbar vor und während des Lötvorganges leicht und definiert an die Kontaktenden 12a bzw. 12b angedrückt. In Z-Richtung wird lediglich bis auf einen konstanten Federdruck jedoch nicht maßgesteuert der Niederhalter 100, ausgefahren. Der zu seiner Einstellung angeordnete XY-Tisch 140 wird von der gleichen Steuerung versorgt, die dem XY-Tisch des Laserkopfes 100 zugeordnet ist. Dies gilt selbstverständlich nur für Anlagen mit solchen Tischen.

Die Fig. 7a bis 7c veranschaulichen eine Variante zur wirtschaftlichen Laserbondung mit einem Mehrachsenroboter, also ohne XY-Tisch 110. Auch hier wird der Mehrachsenroboter mit Visionssystem, die automatische Steuerung und der Bestückungs- und Laserbondkopf 100, aktiviert, wodurch die Kalibrierung, Grobpositionierung des Bestückungskopfes über dem Bauelement 13, die Nach- und Feinpositionierung mittels des Visionssystems erfolgt.

Der Laser- und Bestückungskopf 100 arbeitet prinzipiell gleich, lediglich die "Anschlußbeinchen" 16 werden nicht innen am Bauelement (Chip) 13, sondern an den äußeren Enden der Kontaktbügel 12 vor dem Niederhalter 10 angedrückt. Hier erfolgt die Abkopplung vom Niederhalter 10 und Laser-Bestückungskopf 100 elektromagnetisch.

Der abgekoppelte Laser-Bestückungskopf 100 fährt dann nach CIM-Programm (CIM = Computer Integrated Manufacturing = rechnergesteuerte Fertigung) die Positionen der Kontaktanschlüsse 12 ab und verlötet zunächst in der Mitte zur Verklebung des Bauelementes 13 und dann die einzelnen Anschlüsse. Als vorteilhaft erweist sich die Maßnahme, den Laser-Bestückungskopf 100 beim Mehrachsenroboter zusätzlich abwinkelbar auszubilden bzw. zu lagern und zwar so, daß er in einem bestimmten Winkel α in zwei Richtungen auslenkbar ist.

Durch die vorbeschriebenen Ausführungsformen ist nun die Möglichkeit geschaffen, vorverzinn-

te, flußmittel-, pasten- oder kleberfreie Mikrokontakte mittels eines speziellen rahmenförmigen Niederhalters geometrisch so einwandfrei fixiert werden, daß eine optimale Lötverbindung ermöglicht wird.

Patentansprüche

1. Einrichtung zum Laserlöten von Feinkontakten vorbeloteter mikroelektronischer Bauelemente mittels eines Laser-Bestückungskopfes, der programm- und rechnergesteuert von einem Vier- oder Sechssachsenroboter oder XY-Tisch getragen und geführt wird, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Z-Achsen-Verstelleinrichtung (30) des Laser-Bestückungskopfes (100) des Mehrachsenroboters oder XY-Tisches (110) mit einem rahmenförmigen Niederhalter (10) versehen ist, der einen Kapton-(Film)-Rahmen (11) oder direkt die Kontaktenden (12a) mehrerer bis vieler Kontaktbügel (12) des zu verlötenden TAB-Bauelementes (Tape Automated Bonding-Chip) (13) mit definiertem Druck belastet und diese Kontaktenden (12a) so vorgeformt sind, daß bei der Druckbelastung ein mechanischer Kontakt (12b) aller Kontaktbügel (12) an den Leiterbahnanschlüssen (14) erfolgt, der automatisch deren Laserbondung aktiviert.

5
10
15
20
25
2. Einrichtung nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß der rahmenförmige Niederhalter (10) mit einem höhenverstellbaren Saugrüssel (21) an einem Stempel (20) für die gleichzeitige Bestückung und Fixierung der zu verlötenden Bauelemente (13) versehen ist.

30
35
3. Einrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß der rahmenförmige Niederhalter (10) mittels längenveränderlicher Rahmenhalter (22) an dem Stempel (20) oder dem Saugrüssel (21) verbunden ist.

40
4. Einrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 3, **dadurch gekennzeichnet**, daß der rahmenförmige Niederhalter (10) in seinen Dimensionen flach ausgebildet und an seiner Unterseite mit einer Teflonschicht (17) rasterförmig isoliert ist.

45
5. Einrichtung nach den Ansprüchen 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet**, daß der rahmenförmige Niederhalter (10) in zwei Hälften (10a, 10b) geteilt und den verschiedenen Kontaktgeometrien mittels einer Verstelleinrichtung (23) anpaßbar ist.

50
55
6. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet**, daß dem rahmenförmigen Niederhalter (10) zur exakten Positionierung ein XY-Tisch (140), ein Bilderkennungssystem (120) und ein Korrektursteuersystem (130) zugeordnet ist.

5
7. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 6, **dadurch gekennzeichnet**, daß der XY-Tisch (140) des rahmenförmigen Niederhalters (10) von der gleichen Steuereinrichtung gefahren wird, wie der darüber angeordnete XY-Tisch (110) des Laserkopfes (100).

10
8. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 7, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anschlußelemente (16) der Kontaktbügel (12) mit dem Bauelement (Chip) (13) sowohl an dessen Ober- als auch an der Chipunterfläche anbringbar sind.

15
9. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Anschlußelemente (16) der Kontaktbügel (12) an deren äußeren Enden vom rahmenförmigen Niederhalter (10) an das Substrat (Kleberfilm) (15) angedrückt werden und die Abkopplung derselben (16) vom Niederhalter (10) und Laser-Bestückungskopf (100) über eine elektromagnetische Einrichtung erfolgt.

20
25
10. Einrichtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, **dadurch gekennzeichnet**, daß der abgekoppelte Laser-Bestückungskopf (100) entsprechend der Programmsteuerung (CIM) die Positionen der Anschlüsse der Kontaktbügel (12) abfährt und nach Verklebung des Bauelementen-Chips (13) diese Anschlüsse verlötet, wobei der Laser-Bestückungskopf (100) beiderseits der Horizontalen in bestimmten Winkeln (α) verschwenkbar gelagert ist.

30
35
40
45
50
55

FIG. 1

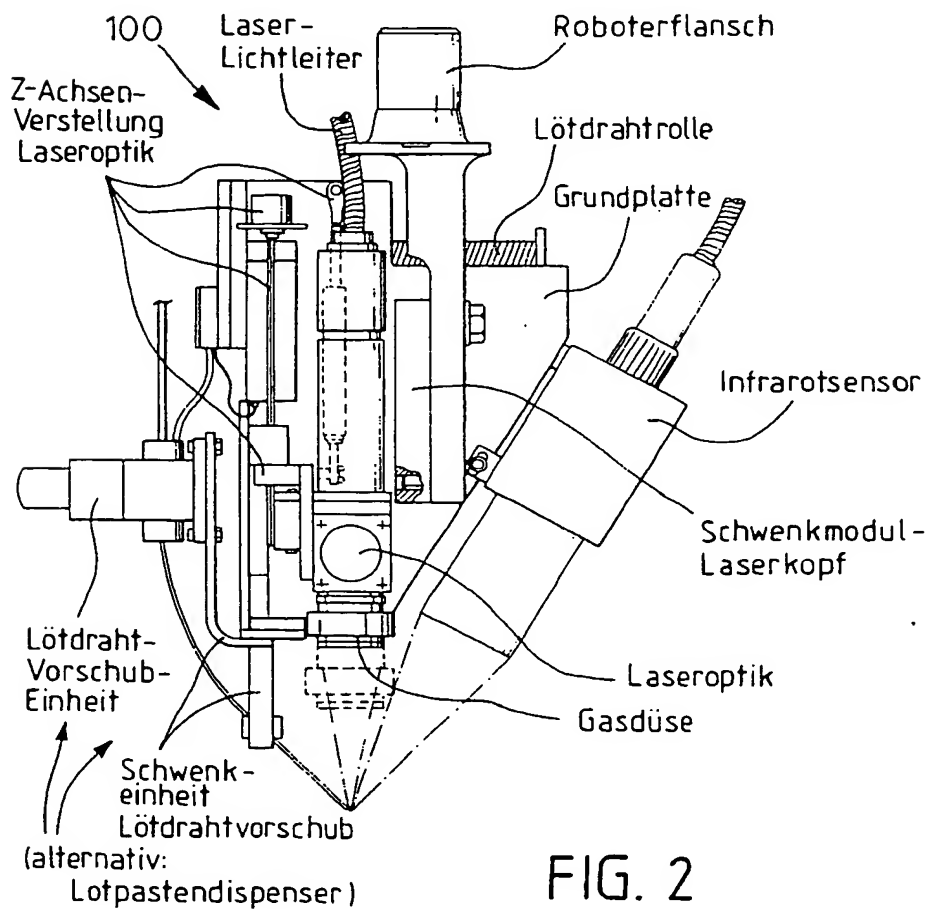
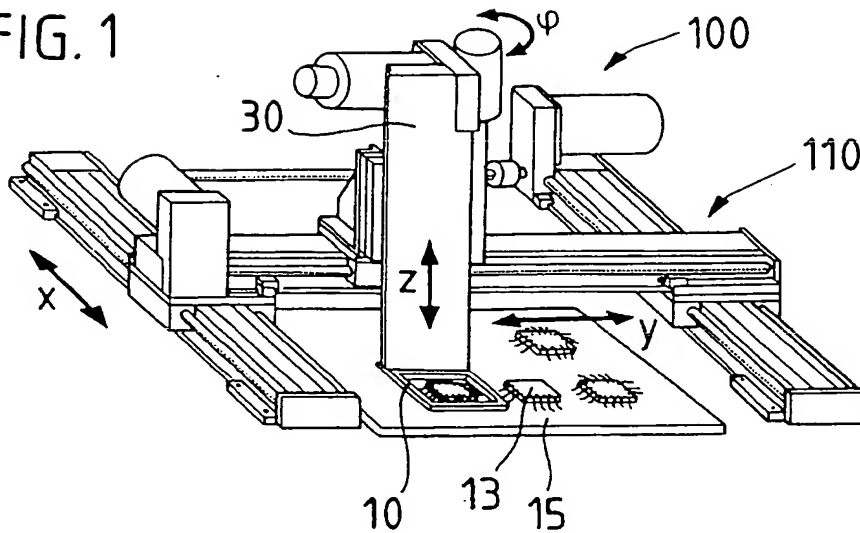


FIG. 2

FIG. 3a

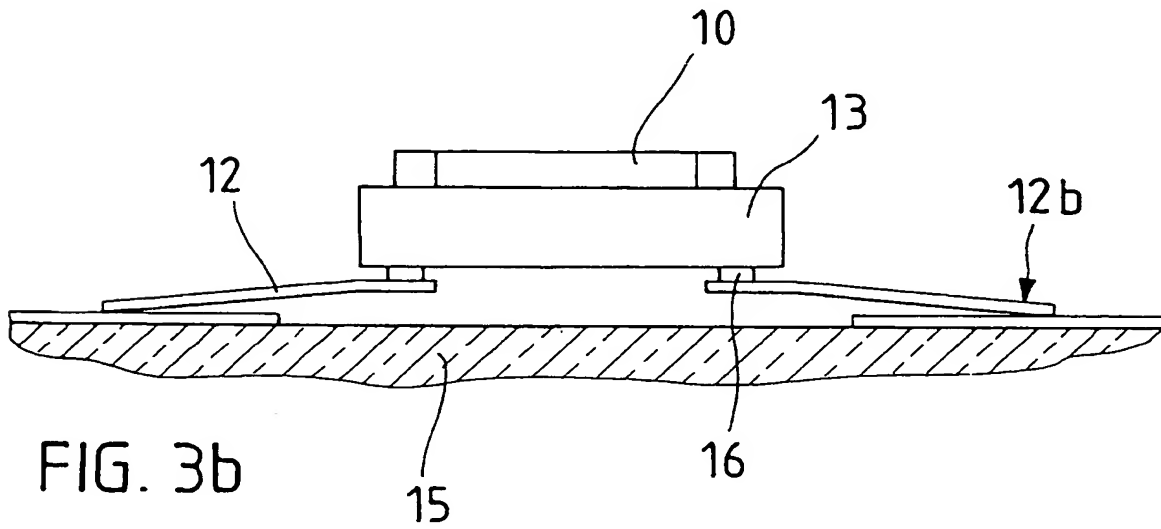
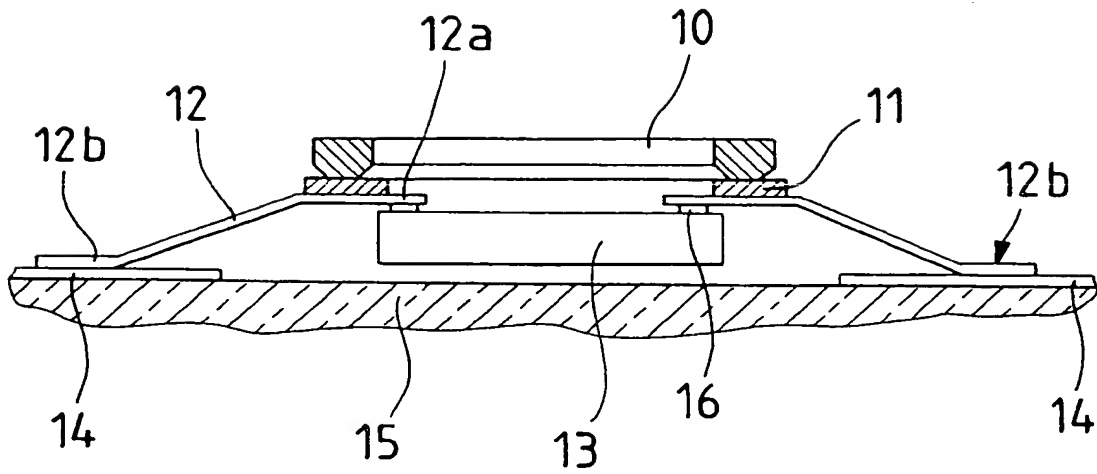
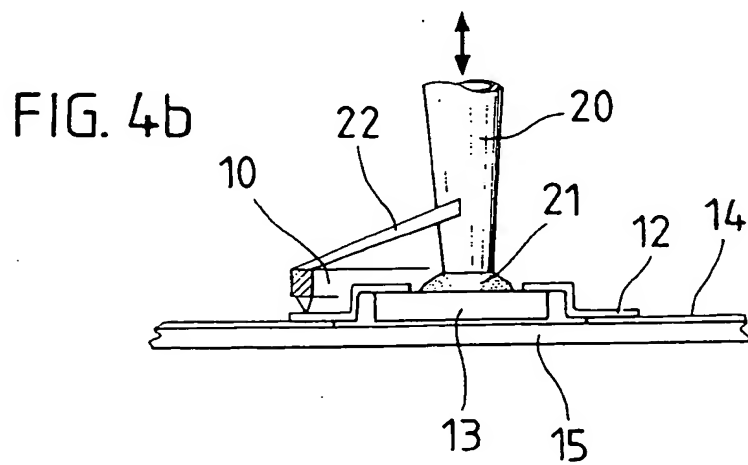
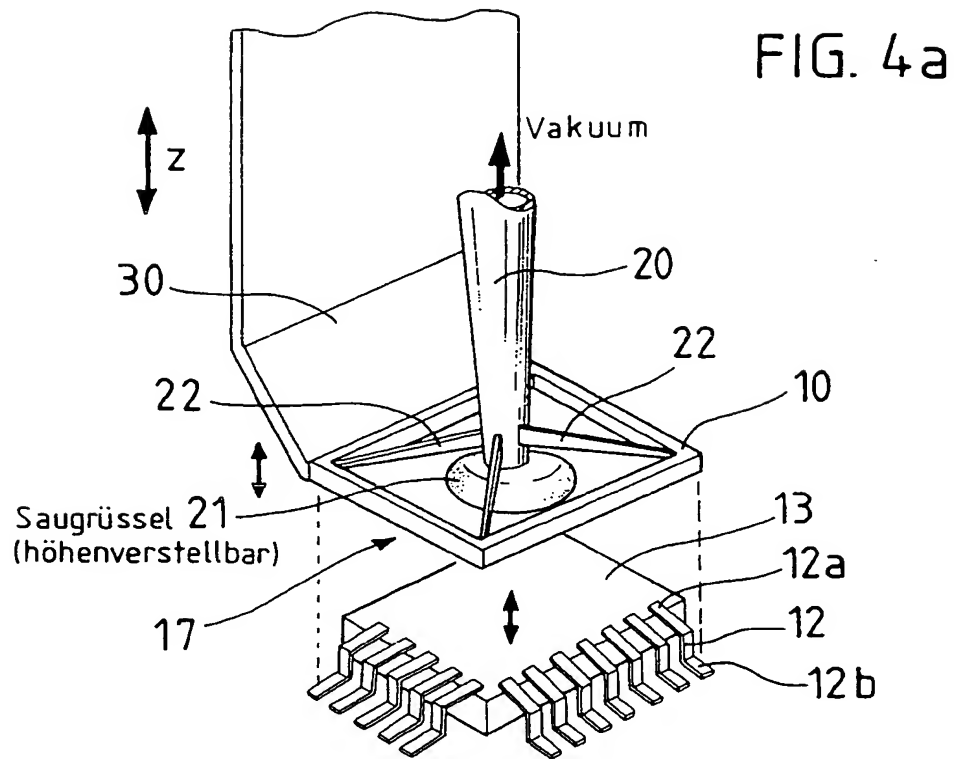


FIG. 3b



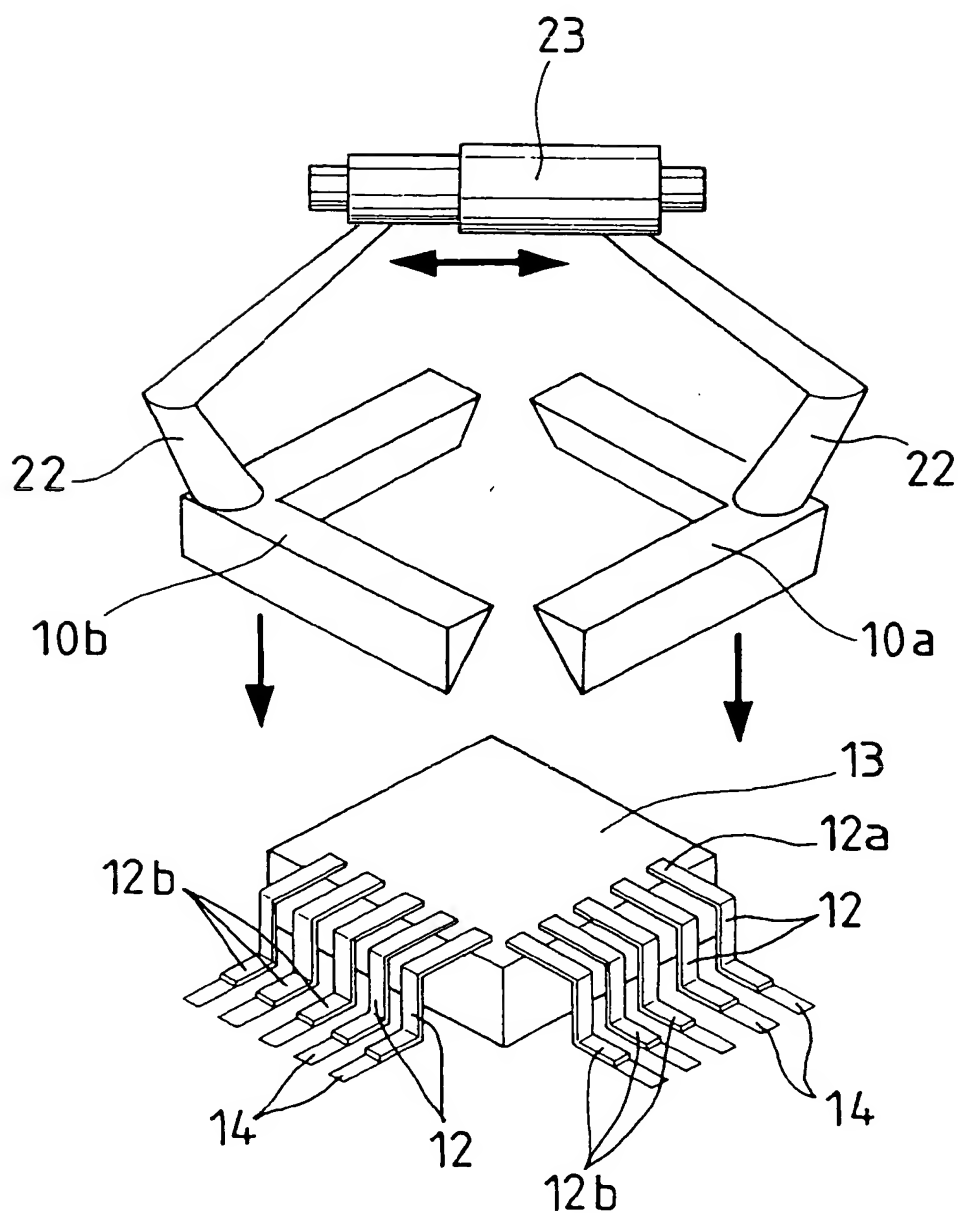


FIG. 5

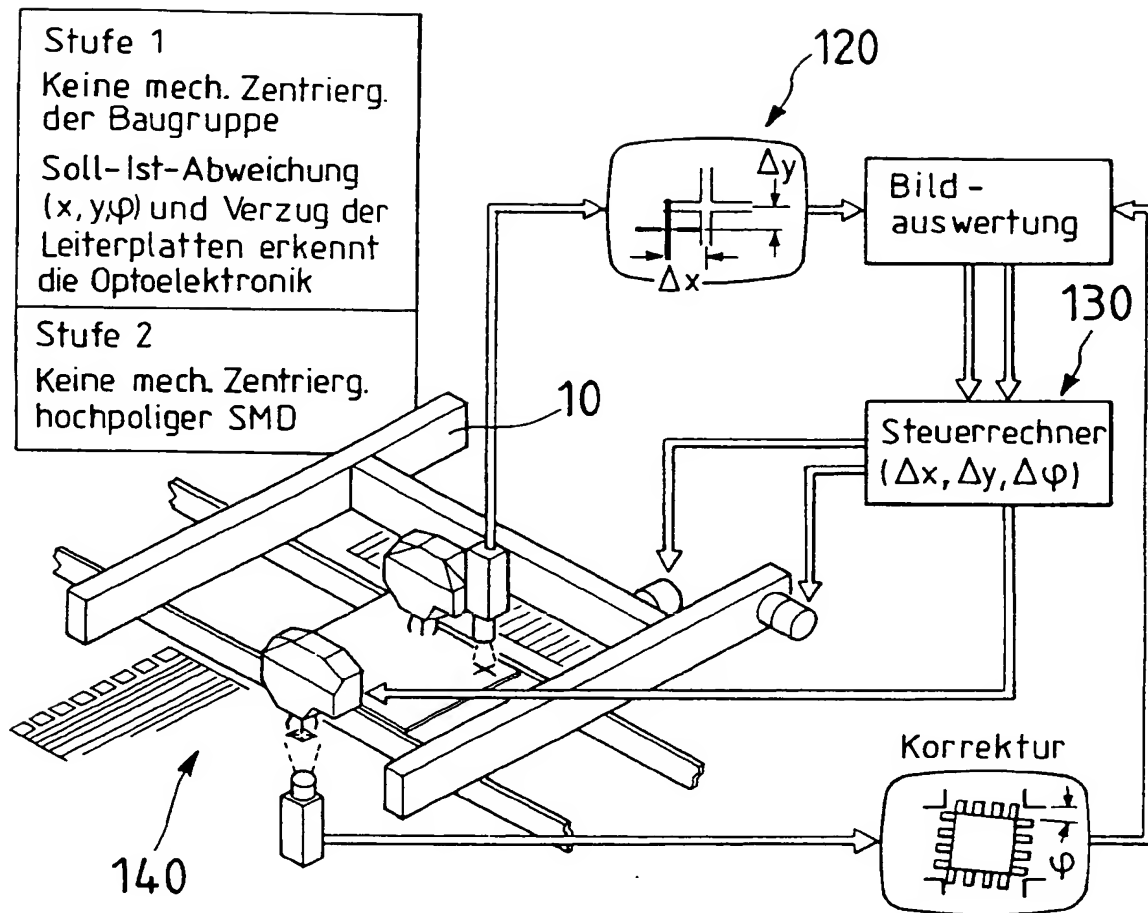


FIG. 6

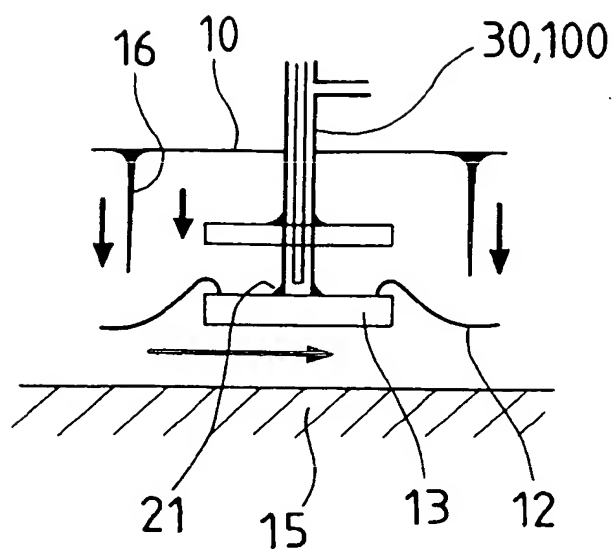


FIG. 7a

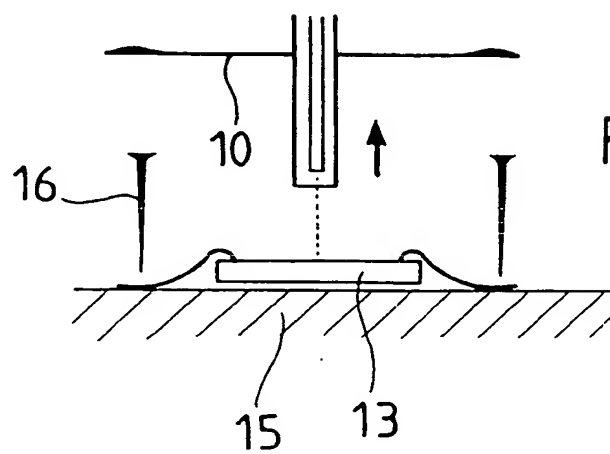


FIG. 7b

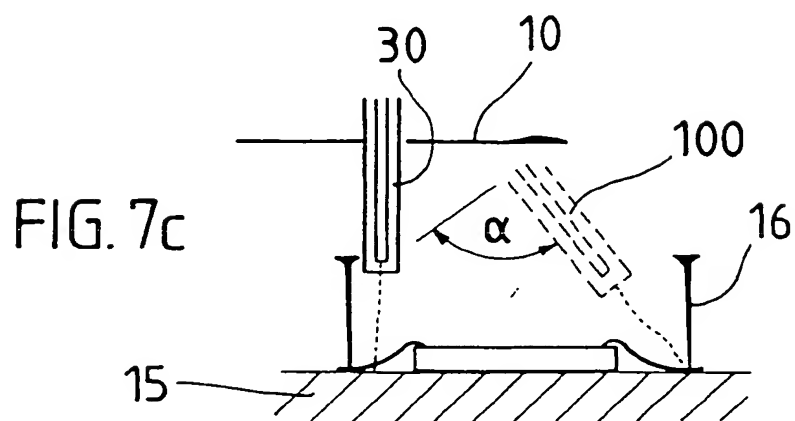


FIG. 7c



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 92 10 2723

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
Y	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 14, no. 546 (E-1008)4. Dezember 1990 & JP-A-2 232 999 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO.) 14. September 1990 * Zusammenfassung *	1,2,6,7	B23K1/005 H05K13/04 H01L21/60 H01L21/68
Y	IBM TECHNICAL DISCLOSURE BULLETIN, Bd. 31, Nr. 6, November 1988, NEW YORK US Seiten 385 - 389; 'LASER MICROWELDING OF TAPE AUTOMATED BONDING COMPONENTS FOR SURFACE MOUNTED TECHNOLOGIES'	1,2,6,7	
A	EP-A-0 326 020 (MICROELECTRONICS AND COMPUTER TECHNOLOGY CORPORATION) 2. August 1989 * Spalte 1, Zeile 19 - Zeile 35 * * Spalte 2, Zeile 23 - Zeile 32 * * Spalte 4, Zeile 36 - Zeile 44 * * Spalte 6, Zeile 29 - Spalte 7, Zeile 17 * * Ansprüche 12,13; Abbildungen 1,3,5,6,7 *	1-10	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			H05K H01L B23K
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchemart DEN HAAG		Abschlußdaten der Recherche 23 JUNI 1992	Prüfer HAEGEMAN M.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 (01.92) (P0407)